

深圳市得润电子股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会相关规定及公司实际情况，就 2020 年度非公开发行股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开已经履行的决策程序、本次非公开发行前上市公司总股本及本次非公开发行股票的数量
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了发行人基本情况中的注册资本
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	将发行人的资产负债率数据更新至截止 2020 年 9 月 30 日
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行方案概况	更新本次非公开已经履行的决策程序、本次非公开发行前上市公司总股本及本次非公开发行股票的数量
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募投项目中“高速传输连接器建设项目”、“OBC 研发中心项目”已取得的批复文件
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	将发行人的资产负债率数据更新至截止 2020 年 9 月 30 日
第四节 本次发行相关风险的说明	二、市场需求波动风险	增加了发行人在本次发行中“市场需求波动风险”的说明
第四节 本次发行相关风险的说明	四、业绩波动风险	增加了发行人在本次发行中“业绩波动风险”的说明
第四节 本次发行相关风险的说明	五、存货减值风险	增加了发行人在本次发行中“存货减值风险”的说明
第四节 本次发行相关风险的说明	六、商誉减值风险	增加了发行人在本次发行中“商誉减值风险”的说明
第四节 本次发行相关风险的说明	七、无形资产和开发支出减值风险	增加了发行人在本次发行中“无形资产和开发支出减值风险”的说明

第四节 本次发行相关风险的说明	八、流动负债占比较高的风险	增加了发行人在本次发行中“流动负债占比较高的风险”的说明
第四节 本次发行相关风险的说明	十一、实际控制人质押比例较高风险	增加了发行人在本次发行中“实际控制人质押比例较高风险”的说明
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新发行人最近三年，即 2017 年度至 2019 年度的现金分红情况
第六节 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次非公开发行摊薄即期回报测算中的假设条件、对主要财务指标的影响

具体内容详见公司同日披露的《深圳市得润电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二一年一月六日